



2023年7月19日

各位

会社名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問合わせ先 I R 室 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社におけるマレーシアでの設備投資（新工場建設）に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の当社取締役会で、パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社である江蘇富楽華半導体科技股份有限公司（以下、「FLH」）において、マレーシアでの設備投資（新工場建設）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 投資の背景等

- ・当社パワー半導体事業は電気自動車業界、太陽光発電を中心とする新エネルギー業界等の発展と世界的電動化趨勢の影響を受け急速な拡大を遂げております。また、当社は世界的な大手顧客企業との長期的な戦略協力関係を築いており、これらの顧客側からも長期的発展を期待されております。
- ・こうしたなか、当社は中国国内において上海、東台、そして四川と生産拠点を着々と増やし顧客ニーズにこたえて参りましたが、昨今の経営環境の変化及び大手顧客への対応の必要性を鑑み、この度マレーシア南部地区に新たに生産拠点を設置することを決定いたしました。この新工場建設により、成長著しいパワー半導体市場の需要を取り込み事業拡大に注力いたします。
- ・今回の製造拠点設置に関しては、既存工場を買収した上で内装と改造を行うことで、立上げのスピードアップと投資金額の抑制を狙います。
- ・また、現地にて本拠点の管理・運営を行う子会社を新たに設立する予定です。
- ・過去の適時開示経過を<ご参考>「Appendix. I FLHに関する既往開示内容一覧」に記載しておりますのであわせてご参照ください。

2. 設備投資の概要

(1)	投資金額	694,600千中国元（約137億円） (1中国元=19.71円)
(2)	新工場建設地	マレーシア南部地区柔仏州新山地区
(3)	投資の内容	・工場建屋等：265,000千中国元（約52億円） (建屋総床面積：約34,000㎡) ・機械設備：309,000千中国元（約61億円） ・その他：120,000千中国元（約24億円）
(4)	生産能力	DCB基板：30万枚/月、AMB基板：20万枚/月
(5)	スケジュール	・建屋改造設計：2023年7月 ・建屋改造開始：2023年9月 ・機械設備設置開始：2024年5月
(6)	操業開始予定	2024年9月

3. 子会社の概要 (2023年3月31日現在)

(1)	名 称	江蘇富樂華半導體科技股份有限公司 (FLH)	
(2)	所 在 地	中国江蘇省東台市城東新区鴻達路 18 号	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売	
(5)	資 本 金	417,074 千中国元 (約 82 億円) (1 中国元=19.71 円)	
(6)	設 立 年 月 日	2018 年 3 月 16 日	
(7)	大株主及び持ち分比率	株主名	持ち分比率
		上海申和投資有限公司 (略称 FTS)	55.1%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社である FTS が議決権の 55.1%を保有する子会社
		人 的 関 係	当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

3. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

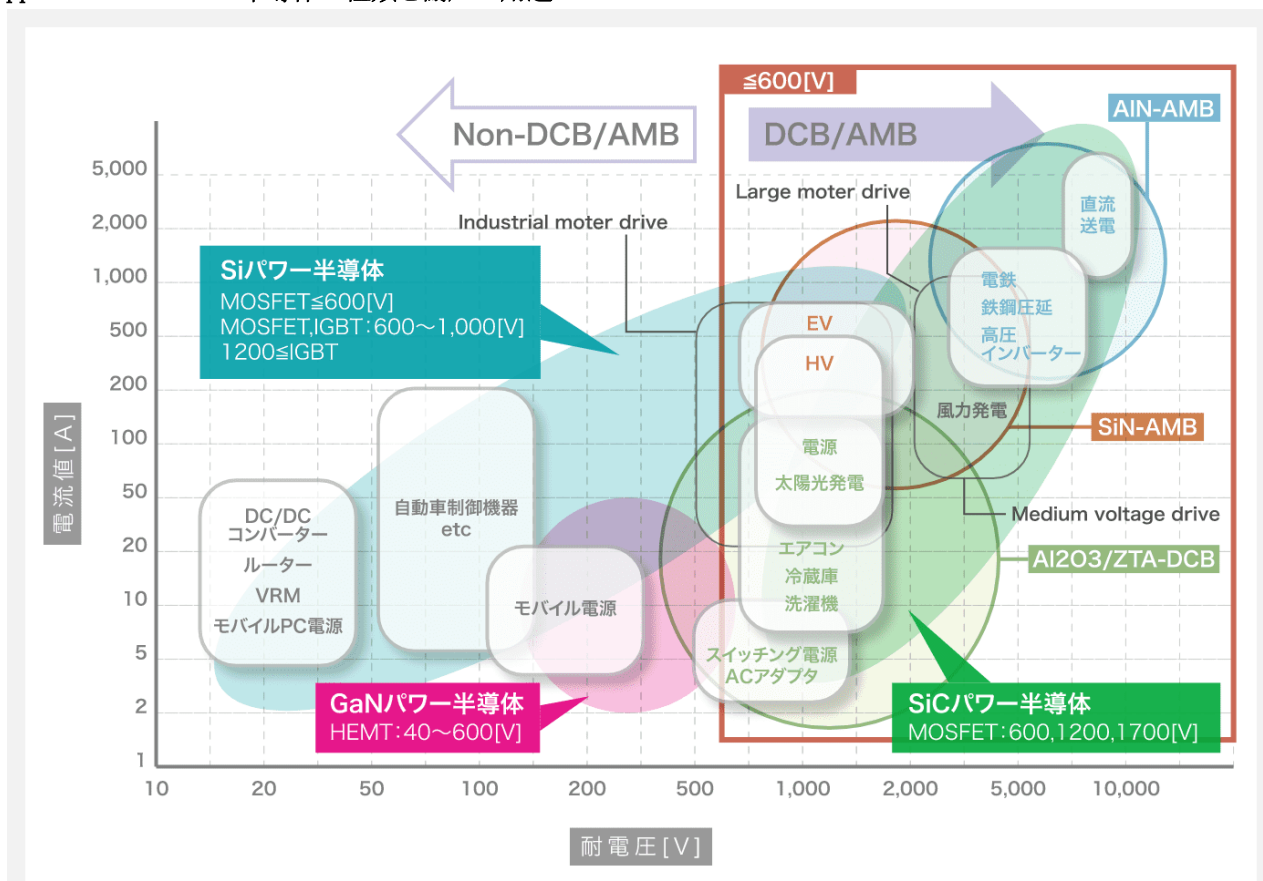
以 上

<ご参考>

Appendix. I FLH に関する既往開示内容一覧

開示日	表題
2022/12/16	「(開示事項の変更)パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第五回)」
2022/11/15	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第五回)」
2022/7/20	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社における設備投資(新工場建設)に関するお知らせ」
2022/5/27	「(開示事項の変更・訂正)パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第四回)」
2022/3/17	「(開示事項の訂正)パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」
2022/3/16	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第四回)」
2022/3/7	「半導体用絶縁放熱基板製造子会社における投資契約締結のお知らせ」
2022/2/25	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による華泰連合証券との上場に関するアドバイザー契約の締結、および 中国証券監督管理委員会による登録のお知らせ」
2021/8/6	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」
2021/4/28	「(開示事項の変更)パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」
2021/4/15	「パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」
2021/3/19	「(開示事項の追加・訂正)パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第二弾)」
2021/2/10	「パワー半導体基板子会社の第三者割当増資に関するお知らせ(第二弾)」
2020/11/17	「パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」

Appendix. II パワー半導体の種類と耐圧・用途



DCB/AMB 主な市場範囲：産業機器、自動車、電気鉄道、再生可能エネルギー